
未來計劃及[編纂]

未來計劃和展望

有關我們未來計劃及策略的詳盡說明，請參閱「業務－我們的策略」。

[編纂]

我們估計，在扣除[編纂]、費用及我們就[編纂]應付的估計開支後，假設[編纂]為每股[編纂]，本公司將收到[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元。我們目前擬將該等[編纂]用於以下用途：

- 約[編纂]%（或[編纂]百萬[編纂]）將用於擴充產能。該項投資為我們增長策略的核心部分，旨在強化後端基礎設施，以支持擴張業務營運，並確保具備高質、高效及合規的生產能力。具體而言，
 - 約[編纂]%（或[編纂]百萬[編纂]）預期將用於購買新生產基地的土地。該基地將作為我們開發及生產高性能電解銅箔產品的主要生產設施。該項採購將確保我們現有生產水平保持競爭力，並能靈活應對不斷演變的市場需求及產品組合的快速調整。
 - 約[編纂]%（或[編纂]百萬[編纂]）預期將用於建設新生產基地。該項計劃重點在於建立生產設施及其他辦公室等配套設施。
 - 約[編纂]%（或[編纂]百萬[編纂]）預期將用於採購生產、辦公及其他用途的設備。本公司的新生產基地預期將配備關鍵先進機器。該等實體儀器設備包括銅溶解槽、變壓器、高低壓櫃及其他生產設備，確保生產的高質量、穩定性及成本效益，從而使本公司在多變的市場中維持競爭優勢。具體而言，本公司將購置大量製箔機系統，包括陰極輓、轉換器及銅母線，該等均為生產超薄鋰電池銅箔（即本公司高性能產品之一）的必要設備。此外，本公司將進行設備安裝工程、生產線佈建及高低壓供電系統建置，確保本公司的生產經營符合適用法規，並恪守本公司對可持續發展實務的承諾。

未來計劃及[編纂]

- 約[編纂]% (或[編纂]百萬[編纂]) 預期將用於銅箔生產廠房初始填充所需的材料。

結合對可擴充的實體基礎設施及先進生產機械的投資，旨在打造具備韌性、高效率及面向未來的生產生態系統，從而以穩定、高品質及合規的產出，為我們不斷擴張業務營運提供可靠支撐。

- 約[編纂]% (或[編纂]百萬[編纂]) 將用於持續投資於本公司的研發活動，以提升技術水平。該項投資旨在改善本公司的研發能力，以滿足新興行業趨勢及特定客戶需求。具體而言，
 - 約[編纂]% (或[編纂]百萬[編纂]) 預期將用於設立及建設全新的現代化研發中心。具體撥款主要包括新建研發中心的場地建設。該中心將作為本公司研發運營及創新活動的核心樞紐，配備各類高性能研發實驗室、檢測室及中試生產設施，旨在提升本公司的尖端生產系統並增強市場競爭力。
 - 約[編纂]% (或[編纂]百萬[編纂]) 預計用於購置高性能研發硬件設備及配套系統軟件，以推動技術升級與新產品開發。此項投入旨在整合先進設備與精密工程，大幅提升工藝效率、精度與控制水平。具體包括採購：(i)研發及測試設備，例如用於固態電池多金屬負極集流體、電子電路銅箔表面處理的裝置。該等設備可精確檢測、識別並處理多種材料、化學元素及金屬污染物，助力研發中心開創精密測試方法，提升整體科技實力；及(ii)研發中心相關的辦公設備與電子裝置。

未來計劃及[編纂]

- 約[編纂]% (或[編纂]百萬[編纂]) 預計用於我們的研發活動，包括(i) 招募研發人才以增強我們的技術能力。該等研發人員 (包括研究員、研發項目經理、測試人員及工程師) 將致力於在整個研發過程中持續推動技術進步；及(ii) 推進現有及未來研發項目，涵蓋內部及第三方測試費用、原材料採購、能源消耗及其他開支。為滿足高速增長的市場需求 (尤其是5G/6G通信、AI服務器及汽車電子領域)，我們將加大對高性能銅箔的資源及人力投入，開發各種抗拉強度等級、表面粗糙度精密可控且電氣性能優異的產品。我們計劃持續開展多個新產品研發項目，主要方向包括：(i) 高頻高速電子電路銅箔 (HVLP4-5)；及(ii) 合金箔固態電池新型負極集流體材料。

通過新建研發中心、配備先進設備、持續引進人才與團隊建設，以及緊扣市場需求的研究項目，該等綜合投資將增強我們的動態適應能力，以應對日益擴大的業務場景與不斷變化的客戶需求。

- 約[編纂]% (或[編纂]百萬[編纂]) 將用作營運資金及其他一般公司用途。

若[編纂][編纂]未立即用於上述用途，則在相關法律法規許可的情況下，所得款項淨額將會存入在持牌商業銀行及/或其他認可金融機構 (定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律法規) 開立的短期計息賬戶。